(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
26. Mai 2006 (26.05.2006)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2006/053690 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:
H01L 21/00 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/012143

(22) Internationales Anmeldedatum:
12. November 2005 (12.11.2005)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2004 055 449.8
17. November 2004 (17.11.2004) DE

(71) Anmelder *(für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US)*: **STEAG HAMA TECH AG** [DE/DE]; Ferdinand-von-Steinbeis-Ring 10, 75447 Sternenfels (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder *(nur für US)*: **SAULE, Werner** [DE/DE]; Elisabeth-Selbert-Strasse 7, 75015 Bretten (DE). **BERGER, Lothar** [DE/DE]; Jahnstrasse 63, 75428 Illingen (DE). **KRAUSS, Christian** [DE/DE]; Ilse-Graulichweg 7, 72810 Gomaringen (DE). **WEIHING, Robert** [DE/DE]; Knittlinger Strasse 4, 75417 Mühlacker (DE).

(81) Bestimmungsstaaten *(soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart)*: AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten *(soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart)*: ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:
— *mit internationalem Recherchenbericht*

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) **Title:** METHOD AND DEVICE FOR THERMALLY TREATING SUBSTRATES

(54) **Bezeichnung:** VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM THERMISCHEN BEHANDELN VON SUBSTRATEN

(57) **Abstract:** The invention relates to a device for thermally treating substrates, wherein the substrates are maintained in contact with or are narrowly distanced from a heating plate which is heated via a plurality of separately controllable heating elements on the side of the heating plate facing away from the substrate. The heating plate is surrounded at least on the plane thereof by a frame which is distanced therefrom and gas is guided in a controlled manner through a gap between the frame and at least one edge of the heating plate.

(57) **Zusammenfassung:** Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum thermischen Behandeln von Substraten, bei dem bzw. bei der die Substrate in Kontakt mit oder eng beabstandet zu einer Heizplatte gehalten werden, die über eine Vielzahl von separat ansteuerbaren Heizelementen auf der vom Substrat abgewandten Seite der Heizplatte erwärmt wird, wobei die Heizplatte wenigstens in ihrer Ebene von einem hierzu beabstandeten Rahmen umgeben ist und in gesteuerter Weise Gas durch einen Spalt zwischen dem Rahmen und wenigstens einer Kante der Heizplatte geleitet wird.

WO 2006/053690 A1